

Confidential

UI **UI Science Profile**
Equipment for next generation

友藍科学株式会社

Profile of UI SCIENCE

Confidential

○社名 友藍科学株式会社

○住址 千葉県柏市高田1059-5
电话 04-7137-7383 FAX 04-7137-7384

○公司简介

创立 2016年 9月
资本金 ¥100,000,000
主要来往银行 千葉銀行
代表取締役 梅本 伸一

○提供各种设备

卷式连接器选择性电镀设备
全自动晶圆 电镀设备
半自动晶圆 电镀设备
导线架 电镀装置 片式 或 卷式
挂镀式、滚镀式 电镀设备
医疗机器设备、造船设备、自动搬送机、实验装置
电镀治具(各种电镀治具、铸造加工硅胶膜)



友蓝SCIENCE 设备的未来方向

- 我司、累积20年的电镀设备经验,提供最先进技术的电镀设备专家。
- 我们的设备、是依照客户的需求与想法,完成客制化的专业设计成品。
- 我们的设备、将朝着替客户节省空间、节省能源、降低Running Cost 的目标而努力。

組織体制

役員(營業兼)	1名	
經理、總務	3名	
營業	1名	
機械設計	2名	
生產管理	2名	
製造	4名	
システム制御	2名	総員数15名



Introduction of Plating equipment.

Confidential

卷式连接器部分选择性电镀设备

型号 : UIRC-02 ~04

列数 : 2列~4列(最多4列)

处理速度 : 1.0~25.0m/min

需求产品 : 连接器材、或线材

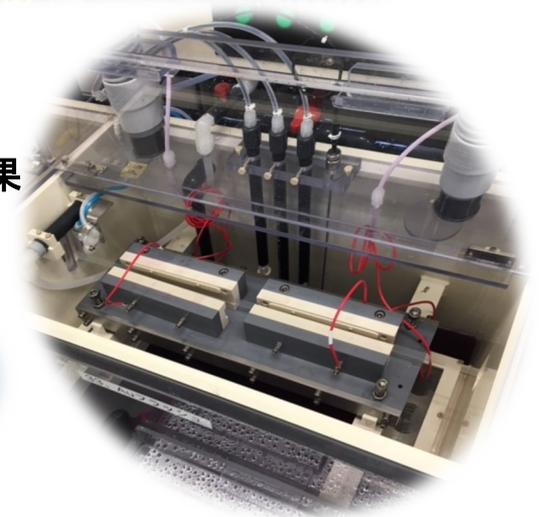
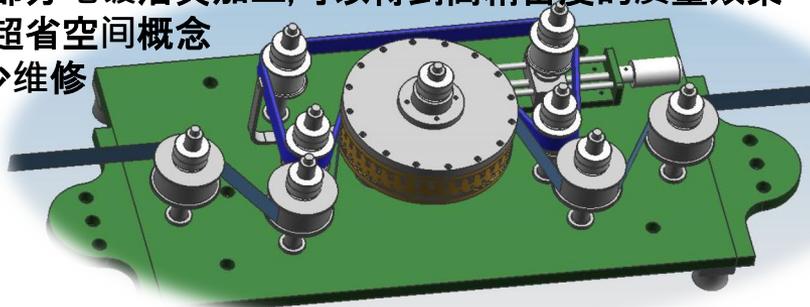
可镀金属选择 : 全面Ni+部分Pd+部分Au+部分Sn
: 全面Cu+全面Sn+Reflow ..等

被镀材料 : Cu合金、SUS ...等



○设备设计概念

- 超小间隙的微型连接器,由于机台的稳定性高、可以得到更好质量
- 車用型精密连接器生产时的稳定传动、可以得到高质量的电镀效果
- 提供各种部分电镀治具加工,可以得到高精密度的质量效果
- 简洁设计超省空间概念
- 省能源、少维修



Introduction of Plating equipment.

Confidential

全自动 Wafer电镀设备

型号 : UIWA-03~012

电镀Cup 数 : 4~8Cup(最多8 Cup)

生産片数 : 约3000片/月

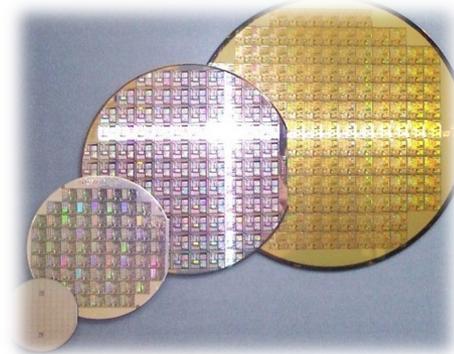
可镀尺寸 : 3-4-5-6-8-12 inch

可镀金属 : Cu、NI、Au、Sn

被镀材料 : Si Wafer / GaAs Wafer
GaN Wafer / 其他材质Wafer

○设备设计概念

- 搭载水平多轴式Robot安定搬送、可以得到稳定的品质
- 独创的Face down Cup设计,可得到最高质量的电镀效果
- 简洁的设计及超省空间的概念
- 省能源,少维修



Introduction of Plating equipment.

Confidential

半自动(手动上料)Wafer电镀设备

型号 : UIWM-03~012

电镀Cup数 : 2~14Cup(最多14Cup)

生产片数 : 约9000片/月

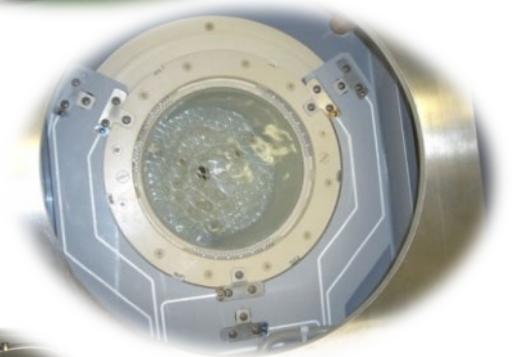
可镀尺寸 : 3-4-5-6-8-12inch

可镀金属 : Cu、Ni、Au、Sn

被镀材料 : Si Wafer /GaAs Wafer
GaN Wafer/其他 材质Wafer

○设备设计概念

- 独创的 Face down Cup设计,可以得到最高质量的电镀效果
- 简洁的设计及超省空间的概念
- 省能源,少维修
- 2 Cup~14 Cup均可提供(低预算,高产能的最佳选择)



Introduction of Plating equipment.

Confidential

导线架电镀设备

卷式部分选择性电镀机

型号 : UIRLF-02 ~04

列数 : 2列~4列(最多4列)

处理速度 : 2.0~5.0m/min

被镀材料 : Cu 材, 42合金 及其他

可镀金属 : Cu、Ni、Ag、Au、Sn



○设备设计概念

- 独创的电镀模具(RDV Type),
可以得到最高品质的电镀效果
- 点状电镀的精度可达 ± 0.07 以下
- 简洁的设计,操省空间的概念
- 省能源,少维修



Introduction of Plating equipment.

Confidential

导线架电镀设备

片式部分选择性电镀机

型号 : UICLF - 04 or 06

列数 : 4列(最多6列)

处理速度 : 1.6 ~ 2.0m/min

被镀材料 : Cu 材, 42合金 及其他

材料尺寸
宽 : 20~110 mm
长 : 120~300 mm
厚 : 0.10~0.25 mm

可镀金属 : Cu、Ni、Ag、Au、



○设备设计概念

- 独创的电镀治具(RDV Type),可得到最高品值的效果
- 点状电镀精度 ± 0.05 以下
- 简洁的设计及超省空间的概念
- 省能源、少维修

Introduction of control system

Confidential

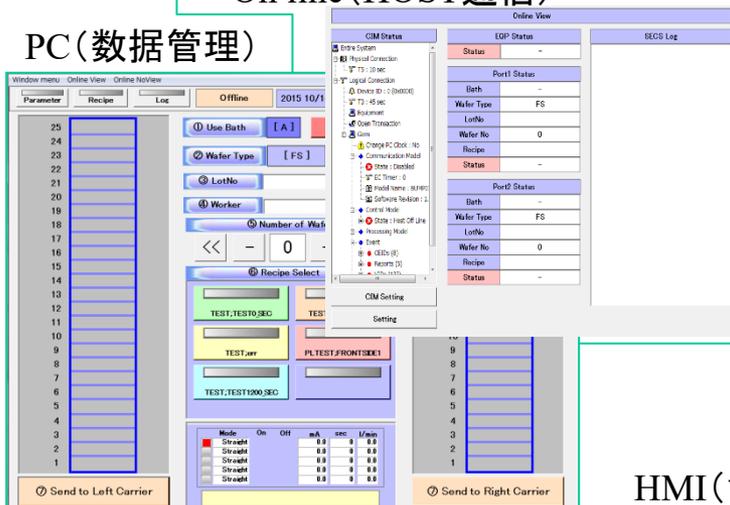
本司的各种控制设备,都可由多样化的网络传输来操控机器。实现了能在生产在线直接控制的愿望。



客制化HOST serve
SECS/GEM

On line (HOST通信)

PC (数据管理)



- 设备控制 (输送、Robot操控等)
- レシピD/L、data收集、警报履歴管理 (PC控制)
- レシピU/L、主动通信管理 (在线直接控制)

PLC (设备制御)

PLC (设备制御)



Melsecnet/H



设备间通讯

Ethernet

HMI (设备控制)

CC-Link
FA通讯

水平多关节Robot (多轴型)



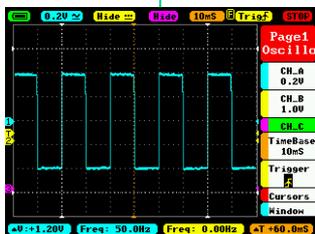
Ethernet

多功能画像検査装置



In line画像検査

Ethernet



电流控制基板操控、喷流控制等

RS-232C通信

Access to UI SCIENCE

Confidential

最寄り駅までのアクセス

東京駅から電車で35分
羽田空港から電車で60分
バスで75分
成田空港から電車で60分
バスで90分



本社工場12m×25m
第二工場15m×31m



Confidential



Thank you